

SEMICON JAPAN 2023 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、このたび「SEMICON JAPAN 2023」へ出展する運びとなりました。
今後の技術革新の核となる生成AI向け半導体や、トレンドの車載半導体など多様なパッケージの成形技術のご提案や、世界各地のお客様へのサポート体制のご紹介を行います。
ご多忙の折とは存じますが、何卒ご来場のうえご高覧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日時 : 2023年12月13日(水)~15日(金)

10:00~17:00

場所 : 東京ビッグサイト 東館

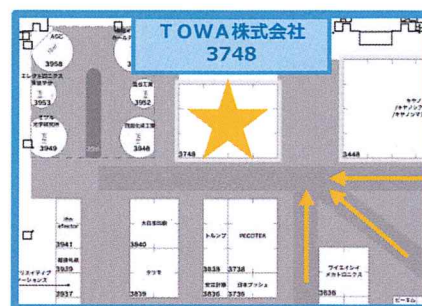
小間 : Hall 3 No.3748

備考 : ご来場には招待券が必要です。

下記特設HPよりご登録をお願いいたします。

HP : <https://www.towajapan.co.jp/jp/semiconjapan2023/>

HP VIP招待券



■ 展示内容

1 AI向けモールドイング技術

生成AIで注目されている2.5D/3D/Chiplet等の最先端半導体向けWLP/PLPプロセスに貢献するコンプレッションモールドイングを含むトータルソリューションをご紹介。

2 モバイル製品向けモールドイング技術

RFモジュールやメモリーなどのデバイスに、低圧成形技術+狭GAP樹脂充填技術のご提案。その他、高放熱性材料の成形技術や多機能化を実現する両面成形技術をご紹介。

3 車載半導体向けモールドイング技術

トレンドのパワー半導体に、放熱板露出成形技術のご提案。その他ECUなどの車載デバイスに対し、信頼性向上・パッケージの小型化に貢献する成形技術などをご紹介。

4 シングュレーション技術

大小様々な製品の個片カット技術のご紹介。合わせて自動化に伴う省人化設備をご提案。その他実装基板の高精度カットなど、シングュレーション技術および自社製ブレードをご紹介。

5 レーザ技術

TOWAレーザーフロント株式会社より、ウェハマーキングをはじめとした、レーザを活用した切断・トリミング・溶接加工技術をご紹介。

6 ラボラトリー・ものづくりサポート体制

アドバンスドパッケージに切り離せない試作・プロセス開発を支えるラボ活動のご提案。お客様のお問い合わせから試作・量産まで一貫した安心のサポート体制をご紹介。